

Jetzt anmelden:

<https://epp.industrie.de/innovationsforum-deutschland/>



EPP

**Innovations
FORUM+**

**Die Zukunft der Elektronikfertigung
gemeinsam gestalten**

15. April 2026

9:00 bis 17:00 Uhr

Kongresshalle Böblingen

Alle wichtigen Informationen rund um die Elektronikfertigung an nur einem Tag – Fachwissen von Experten für Ihren beruflichen Alltag. Besucher können zwischen zwei parallel verlaufenden Vortragsreihen wählen. Zusätzlich gibt es eine Table-Top-Ausstellung der Partner und Ausstellungsrundgänge zu den Themen Lösungen mit KI sowie Workflow & Service.

Inhaltliche Schwerpunkte des EPP InnovationsFORUMs+ 2026 sind:

- KI und Digitalisierung
- Automatisierung und Smart Manufacturing
- Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz
- Leistungselektronik
- Advanced Packaging
- Resiliente Fertigung

Unterstützende Partner:



**Jetzt
anmelden!**

**Ihr
Promo-Code
XPLAIN26**

Unsere
Premium-
Partner:



Unsere Premium-Light Partner:



Unsere Standard-Partner:



	Württemberg Saal	Schwarzwald Saal
Ab 8:00 Uhr	Registrierung	
09:00 - 09:10 Uhr	Begrüßung: Frederick Rindle Chefredakteur EPP / EPP Europe	
09:10 - 09:40 Uhr	Keynote: Supply Chain Resilience – Leiterplattenfertigung	
09:45 - 10:00 Uhr	Analytik zur Risikoprävention – Zuverlässigkeit von Baugruppen gezielt absichern Dr. Mirco Eckardt Technology Analyst ZESTRON Europe ... a Business Division of Dr. O.K. Wack Chemie GmbH	Schablonen & Supply Chain – Bausteine robuster Fertigung Werner Eckert Senior Consultant Christian Koenen GmbH Kevin Heintz Sales Manager DACH Christian Koenen GmbH
10:05 - 10:20 Uhr	Produktionslogistik neu denken – modular, skalierbar, automatisiert, flexibel Uwe Geisler Gesellschafter-Geschäftsführer / Leitung Division smartProLog & SCCE smartTec GmbH	Lasertrimmen und Laserbeschriftung von elektronischen Bauteilen Sven Brückner Technischer Leiter ACI Laser GmbH
10:20 - 11:00 Uhr	Kaffeepause & Networking	
11:00 - 11:30 Uhr	Keynote: Digitale Holographie – Präzision und Geschwindigkeit für die Produktion von morgen Prof. Dr. Daniel Carl stellv. Institutsleiter Abteilungsleiter Produktionskontrolle PK Fraunhofer IPM	
11:35 - 11:50 Uhr	Von Qualität zu Resilienz. Wie datenbasierte Transparenz Lieferfähigkeit sichert. Axel Lindloff Senior Process Specialist Pre-Sales Team Europe Koh Young Europe GmbH	Vom Feuerwehrmodus zur Prozesssicherheit im SMD-Lager Andreas Gerspach Head of Sales & Business Development SmartRep GmbH für Techvalley
11:55 - 12:10 Uhr	Fit fürs Audit – aktuellste (KI-) Features für die auditkonforme X-ray Inspektion! Thomas Winkel Vertrieb Europa Viscom SE	Begrenzte Personalverfügbarkeit meistern: Inspektionsprogrammierung für AOI, SPI & Röntgen vereinheitlichen Daniel Laue Key Account Manager Saki Europe s.r.o.
12:15 - 12:40 Uhr	Ausstellungsrundgang "Lösungen mit KI" und „Workflow & Service“ im Europasaal	
12:40 - 13:30 Uhr	Mittagessen Lunch	
13:30 - 14:00 Uhr	Keynote: Digital Twin meets Automation Thomas Mückl PExecutive Consultant Global Engineering Zollner Elektronik AG	
14:05 - 14:20 Uhr	Datenerfassung von manuellen und automatisierten Prozessen in der smarten Elektronikfertigung B. Eng. Moritz Floder Produkt Manager Digitalisierung Ersä GmbH	Evolution der Automatisierung: So macht smarter Materialfluss den deutschen Mittelstand fit für morgen Felix Moegele Senior Business Development Manager Panasonic Connect Europe GmbH
14:25 - 14:40 Uhr	Mit 100 % Prozesskontrolle zum optimalen Ergebnis! Arne Neiser Produktmanager Wellenlötanlagen SEHO Systems GmbH	Solderpaste-Jetting neu gedacht: Flexibilität für High-Mix & Advanced Packaging Marc Nikutowski Director, EMEA Sales essemtec AG
14:45 - 15:00 Uhr	Fertigung von Leistungselektronik – Trends, Herausforderungen und Umsetzung Michael Schimpf Vertriebsbeauftragter, Sales Manager SCHNAIDT GmbH	Der Materialfluss: Das zentrale Nervensystem der Elektronikfertigung Josef Höving Sales Manager cts Group
15:00 - 15:30 Uhr	Kaffeepause Networking	
15:30 - 16:00 Uhr	Keynote: Advanced Packaging für innovative Elektronik – auch in kleinen Stückzahlen Dr.-Ing. Karl-Peter Fritz Institutsleitung Hahn-Schickard Stuttgart	
16:05 - 16:20 Uhr	Durafuse HR = High-Reliability Lötpasten für anspruchsvolle Elektronik Baugruppen Meik Fratzel Area Sales Manager DA Indium Corporation of America	Ist der Laser die neue Fräse? Sebastian Siemes-Haidle Product- and Business Unit Development Manger SCHUNK Electronic Solutions GmbH
16:25 - 16:40 Uhr	Taktiken für Thermoelemente: Befestigungsmethoden im Vergleich beim thermischen Profiling Dr. Julia Traut Leitung Produktmanagement und Marketing SmartRep GmbH für KIC	Laser Nutzentrennen: Mehr Leistung – mehr Potential Patrick Stockbrügger Product Manager LPKF Laser & Electronics SE
ab 16:45 Uhr	Verabschiedung	